

中国材料研究学会

材学办〔2024〕04号

中国材料大会 2024 暨第二届世界材料大会 会议通知（第一轮）

“中国材料大会”是中国材料研究学会的学术年会，是重要的系列品牌会议之一，是中国新材料界学术水平最高、涉及领域最广、前沿动态最新的超万人学术大会，是面向国家重大需求、推动新材料前沿重大突破的高水平品牌大会。

为推动经济社会高质量发展，加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强，拟于2024年7月8-11日在广东省广州市举办中国材料大会 2024，同期召开第二届世界材料大会。会议涵盖能源材料、环境材料、先进结构材料、功能材料、材料设计制备与评价等5大类主题；同时开设一批特色论坛，包括青年论坛、特色新材料论坛、材料教育论坛、材料期刊论坛等。除此之外，还同期举行国际新材料科研仪器与设备展览会等。会议主要内容如下：

一、组织机构

主办单位：中国材料研究学会

支持单位：广州市人民政府

二、大会日程

7月8日，参会代表报到

7月9日上午，开幕式及大会报告

7月9日下午-7月10日上午，分会交流

7月10日下午，分会交流，Poster交流

7月11日全天，分会交流

三、分论坛设置

A01-能源转换与存储材料

A02-水系电池

A03-核材料

A04-有机太阳能电池

A05-油气田材料

A06-纳米材料合成及光/电催化应用（国际会场）

B01-光催化材料

B02-生态环境材料

B03-水处理功能材料

B04-资源材料与循环利用

B05-环境分离净化材料与技术

B06-可持续发展材料与循环利用（国际会场）

B07-低碳材料与可再生资源（国际会场）

B08-矿物功能材料

C01-粉末冶金

C02-高性能铝合金

C03-先进镁合金

C04-高温合金

C05-高性能钛合金材料

C06-金属基复合材料

C07-空间材料科学技术

C08-超高温结构材料与防护涂层

C09-先进结构陶瓷制备与表征

C10-微结构与强韧化

C11-金属材料强韧化与损伤失效

C12-兵器材料科学与技术

C13-先进钢铁材料

C14-结构材料热-动力学

C15-高性能水泥与混凝土

C16-极端服役环境下材料性能与评价

C17-低温材料

C18-功能梯度材料(国际会场)

C19-难熔金属材料

D01-超材料与多功能材料

D02-多铁性材料

D03-非晶与高熵合金

- D04-极端条件材料与器件
- D05-智能材料
- D06-先进微电子与光电子材料
- D07-生物医用材料
- D08-纳米多孔金属材料
- D09-纤维材料改性与复合技术
- D10-高分子材料
- D11-电子材料与微系统
- D12-先进磁性功能材料
- D13-水凝胶材料
- D14-碳点功能材料
- D15-微纳能源材料与器件
- D16-超导材料与应用
- D17-智能传感功能材料与器件
- D18-仿生材料
- D19-液态金属材料
- D20-多孔吸附与催化
- D21-多尺度光学、电学材料及器件
- D22-先进陶瓷材料
- D23-智能医药材料与器件
- D24-功能分子材料与器件
- D25-光子材料与器件
- D26-智能分子材料(国际会场)
- D27-二维材料与器件
- D28-双碳生态健康功能材料
- D29-多孔材料
- D30-先进半导体光电材料与器件
- D31-先进电工材料电器绝缘技术及应用
- D32-压电电子学及自驱动智能系统
- D33-超硬材料及制品
- D34-功能薄膜
- D35-含能材料(国际会场)
- D36-热管理材料
- D37-量子材料
- E01-材料先进制备加工技术
- E02-材料界面/表面分析与表征
- E03-相分离冶金与材料
- E04-先进凝固科学与技术
- E05-材料服役行为与结构安全
- E06-材料基因组
- E07-增材制造材料
- E08-超声材料科学与技术
- E09-材料表面工程
- E10-材料结构与性能表征技术
- E11-高分子材料老化与服役寿命研究
- E12-人工智能化学与材料学

E13-材料疲劳与断裂
E14-生物基可持续材料（国际会场）
E15-微细加工与成形及晶体塑性力学应用
Z-材料模拟、计算与设计
FB01-环境功能材料青年论坛
FB02-新体系电池青年论坛
FB03-聚集体材料青年论坛

FB04-青年学者前沿闪报大讲台
FC01-集成电路材料创新发展论坛
FC02-能源材料与交叉学科材料国际前沿论坛（国际会场）
FC03-生命健康材料国际前沿论坛（国际会场）
FE01-材料教育论坛

四、投稿与出版

（一）摘要提交

1. 参会摘要请于2024年5月21日17:00前在大会官网按提示提交至系统，无需模版。论文摘要经大会组委会及各分会评审后录用，并制作电子论文摘要集；

2. 摘要内容须完整，包含：所采用的材料和研究技术的主要信息，得到的主要结果，得出的主要结论等；

3. 摘要内容不能包括图、表、公式等；

4. 摘要语言依分会要求确定，国际分会须用英文语言。摘要的提交仅为本次会议使用。

摘要根据参会代表需求提交，非必须。

（二）论文出版

1. 凡内容符合大会主题范围、未在国内外正式刊物或其他会议上发表的论文，均可投递全文，分中文出版和英文出版，分会自行出版的由分会负责；

2. 经大会组委会评审后，符合要求的中文论文将以《中国材

料大会 2024 会议论文集》形式，由《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社网络出版，由《中国重要会议论文全文数据库》及 CNKI 系列数据库收录；优秀论文可被推荐至以下核心期刊：

《材料科学与工艺》（中文核心期刊，Scopus、CSCD 等收录）

《材料研究学报》（中文核心，CSCD、CNKI、EI 等收录）

《稀有金属材料与工程》（中文核心，SCI、EI 等收录）

《中国材料进展》（中文核心，CSCD、CNKI 等收录）

《无机材料学报》（中文核心，SCI、EI、Scopus 等收录）

《陶瓷学报》（中文核心，CA、Scopus 等收录）

3. 经大会组委会评审后，符合要求的英文论文将发表至以下刊物：

《Journal of Physics: Conference Series》（EI 收录，Online ISSN: 1742-6596）

《Springer Proceedings in Materials》（EI 收录，ISSN: 2662-317X）

优秀论文可推荐至以下优质期刊：

《Progress in Natural Science: Materials International》（SCIE, IF=4.7）

《Advanced Fiber Materials》（SCIE/EI, IF=16）

《Journal of Materials Science & Technology》（SCIE/Scopus, IF=10.9）

4. 论文出版服务对象为缴纳过注册费的参会代表，且在论文被录用后，需缴纳版面费；

5. 提交全文时，务必备注所选刊物，否则均默认为会议论文

集出版;

6. 全文提交截止日期为 2024 年 7 月 11 日。

五、注册与缴费

(一) 会议注册

请登录大会官网或扫描二维码进行注册、提交摘要以及缴费等。

会议官网: <https://cmc2024.scimeeting.cn>



会议期间, 食宿统一安排, 住宿费用自理。

(二) 注册费标准 (不含版面费)

类别	2024 年 6 月 21 日 17:00 前缴费	2024 年 6 月 21 日 17:00-7 月 7 日缴费	7 月 8-11 日 现场缴费
学生	1000 元	1500 元	1800 元
非学生	2000 元	2500 元	2800 元

团体 (≥ 10 人) 报名缴费, 享免团体中任一人注册费优惠政策, 该团体中所有成员须在同一注册费标准期内缴费, 且缴费后不接受退费。

如为网上银行汇款, 缴费日期以汇款日期为准。

(三) 注册费缴纳

1. 扫码支付 (推荐)

参会代表登录大会官网, 注册后进行在线支付, 可选择支付宝、微信、银联等在线支付方式。

2. 汇款支付（推荐）

参会代表登录大会官网，选择【汇款支付】，然后根据跳转出的账号进行支付。

3. 现场缴费

如无法采用扫码和汇款支付，可选择现场支付。选择该支付方式不享受优惠注册费金额，均按学生 1800 元，非学生 2800 元的注册费标准缴纳。

4. 汇款支付注意事项

(1) 汇款时务必在用途一栏注明“注册号-姓名”，例：0001-姓名；

(2) 优惠截止日期前注册并成功缴费的参会代表享受注册费优惠政策；

(3) 为便于大家及时领到发票，请尽量申请电子发票。

六、联系方式

贾老师（参会） 010-68710443, 15712976428

闫老师（参会） 010-68710443, 15711486929

刘老师（参会） 010-68710443, 15210936650

E-mail: cmc-public@126.com

李老师（财务） 010-61196085, 13520198012

E-mail: lycmrs@126.com

孙老师（转账、发票） 010-61196085, 13520675663

E-mail: smcmrs@163.com

王老师（展览） 010-68434112, 15611013638

E-mail: wang230201@163.com

郝老师（论文） 010-68726306, 18514661612

E-mail: cmcpapers@126.com

